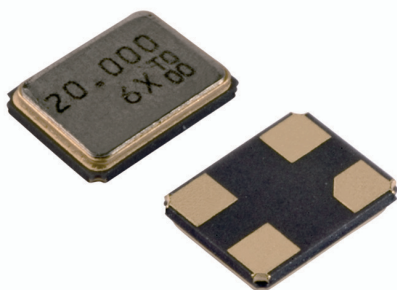


X32F



产品特点及应用范围:



- 体积小
- 准确度高
- 陶瓷封装
- 盘带包装
- 可回流焊接
- 无铅环保产品
- 应用于移动通信
- GSM
- PDC
- CDMA
- PHS

产品性能

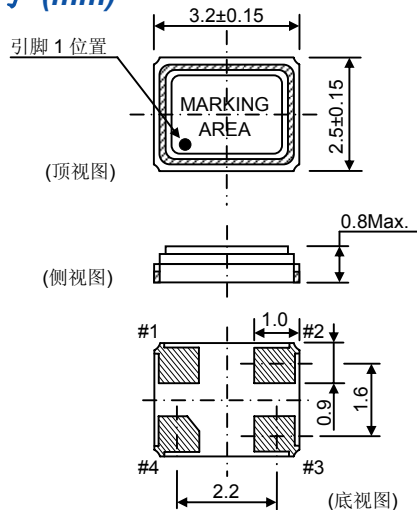
性能参数		X32F
频率范围	F_0	12.000MHz~50.000MHz
振动模式	Mode	AT 基频
串联谐振电阻	R_r	80Ω Max.
频率精度 (25°C 时)	F_{tol}	$\pm 5 \times 10^{-6} \sim \pm 30 \times 10^{-6}$
储存温度范围	T_{STG}	-55°C~+125°C
静电容	C_0	7pF Max.
负载电容	CL	6pF~50pF 或串联
绝缘电阻	IR	>500MΩ DC/100V±10V
激励功率	DL	0.01mW~0.1mW
老化率	F_{age}	$\pm 3 \times 10^{-6} \sim \pm 5 \times 10^{-6}$ /年

频率温度稳定度

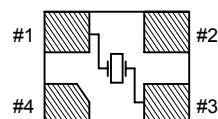
工作温度范围	频率稳定度					
	O: $\pm 10 \times 10^{-6}$	P: $\pm 15 \times 10^{-6}$	Q: $\pm 20 \times 10^{-6}$	S: $\pm 30 \times 10^{-6}$	T: $\pm 50 \times 10^{-6}$	U: $\pm 100 \times 10^{-6}$
B: -10°C~+60°C	●	●	●	●	●	●
C: -20°C~+70°C		●	●	○	●	●
△G: -40°C~+85°C			●	●	●	●
▽Q: 40°C~+125°C					◎	◎
☆J: -55°C~+125°C					◎	◎

●: 可选产品 ○: 常规产品 ◎: 定制产品 △: 工业级产品 ▽: 汽车级产品 ☆: 军品级产品

外形尺寸 (mm)



内部连接示意图



引脚	功能
#1	输入
#2	接地
#3	输出
#4	接地

晶体谐振器选型指南

HC-49U	C	20	S	S	A	1.8432
封装	工作温度范围	负载电容	频率精度 (25°C)	频率温度 稳定度	振动模式	标称频率 (MHz)
HC-49U	A=0°C~+50°C	00=串联	M=±3×10 ⁻⁶	M=±3×10 ⁻⁶	A=AT-基频	请直接写出 标称频率的 值
HC-49UX	B=-10°C~+60°C	06=6.0pF	N=±5×10 ⁻⁶	N=±5×10 ⁻⁶	B=BT-基频	
HC-33U	C=-20°C~+70°C	08=8.0pF	O=±10×10 ⁻⁶	O=±10×10 ⁻⁶	D=DT 切	
HC-49S	G=-40°C~+85°C	10=10pF	P=±15×10 ⁻⁶	P=±15×10 ⁻⁶	N=NT 切	
HC-49SU	Q=-40°C~+125°C	12=12pF	Q=±20×10 ⁻⁶	Q=±20×10 ⁻⁶	X=X 切	
HC-49SN	J=-55°C~+125°C	16=16pF	S=±30×10 ⁻⁶	S=±30×10 ⁻⁶	TA=AT-3 RD	
HC-49SA		20=20pF	T=±50×10 ⁻⁶	T=±50×10 ⁻⁶	FA=AT-5 TH	
HC-49SB		30=30pF		U=±100×10 ⁻⁶	SA=AT-7 TH	
HC-49XA		50=50pF				
HC-49XB		请直接写出 负载电容的 值				
X25F						
X32F						
X42F						
X53F						
X63F						
X75F						
X53T						
X63T						
UM-1						
UM-5						
AT-26						
AT-38						
AT-39						

DT-26	C	06	Q	32.768
封装	工作温度范围	负载电容	频率精度 (25°C)	标称频率 (KHz)
DT-14	A=0°C~+50°C	06=6.0pF	N=±5×10 ⁻⁶	请直接写出 标称频率的值
DT-26	B=-10°C~+60°C	08=8.0pF	O=±10×10 ⁻⁶	
DT-38	C=-20°C~+70°C	10=10.0pF	P=±15×10 ⁻⁶	
SSP-T7	G=-40°C~+85°C	12=12.5pF	Q=±20×10 ⁻⁶	
MC306		请直接写出负 载电容的值	S=±30×10 ⁻⁶	
			T=±50×10 ⁻⁶	
			U=±100×10 ⁻⁶	